

報道関係者各位

2008年11月27日

Corsair Memory 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**Core i7、X58 環境でトリプルチャンネル動作検証済み！ XMP 対応！
DDR3 メモリ DOMINATOR シリーズ TR3X3G1600C8D 発売
容量 3GB(1GB × 3 枚セット)、CL=8-8-8-24、DDR3-1600MHz**

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Core i7、X58 環境でトリプルチャンネル動作確認済み、XMP 対応！容量 3GB(1GB × 3 枚セット)DDR3 メモリ DOMINATOR シリーズ TR3X3G1600C8D を 2008 年 11 月 29 日より全国の PC パーツ専門店にて取扱い開始いたします。

DOMINATOR シリーズ TR3X3G1600C8D は、Intel XMP (Extreme Memory Profile) に対応する PC3-12800(DDR3-1600MHz)規格のデスクトップ用 240Pin DDR3 メモリです。トリプルチャンネル動作に最適な 1GB メモリの 3 枚セットです。Core i7 CPU+X58 マザーボードによる動作検証を行っています。安心してご利用いただけます。

DOMINATOR モジュールは、厳密なテストとスクリーニングを実施し、最適なものだけを選定したメモリモジュールです。選別されたチップは高い信頼性能をもちます。また各機器との相互運用性や各 IC の高周波性能、低レイテンシ性能のテストを徹底的に行い、厳しい基準をクリアしています。



放熱を最大化すると同時に信頼性を向上させる Corsair Memory 独自の冷却技術 DHX (DualPath Heat Exchange) を搭載しています。DHX は伝導と対流という 2 つの熱消散経路で従来では難しかったプリント板(PCB)内の冷却※を実現しています。2 つの熱消散経路とは、プリント板のグラウンド層に銅を採用しプリント板内の熱をアルミニウムヒートシンクへ伝導させる伝導熱消散経路と、4 つのアルミニウムヒートシンクによる対流熱消散経路です。

※標準のチップパッケージ方式ボールグリッドアレイ(BGA)では、グリッドとして編成されたはんだボールの端子が回路基板に接続するリードとなり、チップから生成される熱の 50% がプリント板へ伝導されます。そして従来のヒートシンクは、チップの前面にしか取り付けられないため、チップの背面から生じる熱を除去することができませんでした。Corsair Memory 独自の冷却技術 DHX は、この問題を解決しています。

簡単に安定したオーバークロックを行える機能として、インテルが独自に仕様を策定した XMP (Extreme Memory Profile) 規格に対応しています。対応マザーボードにて、簡単に安定したオーバークロックを行うことができます。

メモリ設定を自動的に行う SPD (Serial Presence Detect) 機能も搭載しています。起動時にメモリに最適にアクセスできるようにメモリコントローラの設定を自動的に行います。複雑なメモリの設定を行わず利用できます。

型番は TR3X3G1600C8D。容量は 1GB が 3 枚で 3GB。メモリ規格は PC3-12800 (DDR3-1600MHz)、デスクトップ用 240Pin DIMM メモリ。転送クロックは 1600MHz。CAS レイテンシは CL=8-8-8-24。ヒートスプレッタを搭載。サイズは 53 × 133mm。永久保証が提供されます。RoHS 適合した環境にやさしい製品です。

■ TR3X3G1600C8D 製品特徴

Corei7 検証済 PC3-12800 (DDR3-1600MHz)

XMS シリーズ TR3X3G1600C8D は、PC3-12800 (DDR3-1600MHz) 規格のデスクトップ用 240Pin DDR3 メモリです。トリプルチャンネル動作に最適な 1GB メモリの 3 枚セットです。Corei7 CPU+X58 マザーボードによる動作検証を行っています。安心してご利用いただけます。

オーバークロック性能を実現した DOMINATOR

厳密なテストとスクリーニングを実施し、最適なものだけを選定したメモリモジュールです。選別されたチップは高いオーバークロック耐性をもちます。また各機器との相互運用性や各 IC の高周波性能、低レイテンシ性能のテストを徹底的に行い、厳しい基準をクリアしています。高い信頼性と最高のオーバークロック性能を提供いたします。

放熱を最大化する独自の冷却技術 DHX

DHX (Dual-Path Heat Exchange) は、放熱を最大化すると同時に信頼性を向上させる Corsair 独自の冷却技術です。メモリモジュールから熱を効果的に除去するために伝導と対流という 2 つの熱消散経路を利用しています。

プリント板も冷却する優れた伝導熱消散

効率の良い伝導熱消散経路を構築するために、特別なプリント板 (PCB) を採用しています。プリント板 (PCB) のグラウンド層に銅を採用することにより、プリント板内の熱を内側のアルミニウムヒートシンクへ伝導させ効率よく消散いたします。この熱消散経路は非常に効果的に、チップの背面から生じる熱を除去いたします。

4 枚のアルミヒートシンクで対流熱消散

効果的な対流熱消散経路を構築するために、4 つのアルミニウムヒートシンクを採用しています。外側の 2 つのヒートシンクはチップ表面に設置され、内側の 2 つのヒートシンクはプリント板 (PCB) に設置されています。接触面と放熱面をコントロールすることにより、効果的な対流熱消散経路を実現しています。削り出しのアルミニウムヒートシンクも特徴です。

オーバークロック機能 XMP 対応

XMP (Extreme Memory Profile) は、インテルが独自に仕様を策定した規格です。SPD を拡張し自動的にメモリのオーバークロックを行なう機能です。XMP 対応マザーボードにて、簡単に安定したオーバークロックを行うことができます。

自動設定機能 SPD 対応

メモリモジュールに搭載されているメモリチップの種類や仕様などをメモリコントローラに伝えるための機能です。SPDに対応しているコンピュータは、起動時にSPDからメモリに関する情報を読み取り、メモリに最適にアクセスできるようにメモリコントローラの設定を自動的に行います。複雑なメモリの設定を行わず利用できます。

Corsair Memory 永久保証

Corsair Memory 社の DRAM メモリモジュール製品には、すべて永久保証が適用されます。Corsair Memory 製品は、製品寿命の続く限り、または保証の及ぶ限り、意図されている運用環境でそれぞれのデータシートで指定されているとおりに動作することが保証されます。

■ TR3X3G1600C8D 製品詳細

型番	TR3X3G1600C8D
容量	3GB(1GB×3枚セット)
規格	PC3-12800(DDR3-1600MHz)
種類	240Pin DDR3-SDRAM Unbuffered DIMM
転送ロック	1600MHz
サイズ	基板サイズ:39×133mm 全体サイズ:53×133mm
レイテンシ	8-8-8-24
SPD	JEDEC standard 9-9-9-24 values at 1333MHz
EPP	--
XMP	XMP 8-8-8-24 values at 1600MHz
トリプルチャンネル	対応
RoHS	適合
ヒートシンク	DHX 搭載
保証	永久保証
動作検証ボード	Core i7 Motherboard Cross Reference 検証 PDF リスト <input type="radio"/> Asus P6T Deluxe <input type="radio"/> Asus Rampage II Extreme <input type="radio"/> Foxconn Bloodrage <input type="radio"/> Foxconn Renaissance <input type="radio"/> Gigabyte GA-EX58-Extreme <input type="radio"/> Gigabyte GA-EX58-UD5 <input type="radio"/> Intel X58SO <input type="radio"/> MSI Eclipse ※2008年11月時点

■ TR3X3G1600C8D 発売情報

-発売日

2008年11月29日

-型番

TR3X3G1600C8D

-店頭予想売価

22.000円前後

-高解像度

http://www.links.co.jp/items/high_TR3X6G1600C8D.jpg

-製品情報ページ:

<http://www.links.co.jp/items/corsair-dominator/tr3x3g1600c8d.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

Corsair Memory 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

Corsair Memory 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽 まゆみ
TEL:03-5812-6143 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F
E-mail: jibiki@links.co.jp
URL: <http://www.links.co.jp>